

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



FIT Hon Teng Limited
鴻騰六零八八精密科技股份有限公司

(於開曼群島以鴻騰精密科技股份有限公司的名稱註冊成立的有限公司，
並以鴻騰六零八八精密科技股份有限公司於香港經營業務)
(股份代號：6088)

自願性公告

此乃鴻騰六零八八精密科技股份有限公司* (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 作出的自願性公告。

本公司董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，於二零二五年二月二十一日，本公司的間接全資附屬公司 New Wing Interconnect Technology (Bac Giang) Co., Ltd (「New Wing」) 與本集團的獨立第三方訂立合資協議 (「合資協議」)，據此，(其中包括) 待合資協議項下若干先決條件獲達成或豁免後，New Wing 同意向合資公司 Goertek Electronics Vietnam Co. Ltd. (「合資公司」) 注入現金 50,000,000 美元，New Wing 及本集團的獨立第三方將分別持有合資公司全部註冊資本的 25% 及 75% (「建議交易」)。合資公司將不會併入本集團的賬目。該建議交易是一項策略投資。

由於建議交易的所有相關適用百分比率均低於 5%，故根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第十四章，建議交易不構成本公司的須予公佈交易。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務須審慎行事。

承董事會命
鴻騰六零八八精密科技股份有限公司*
董事會主席
盧松青

香港，二零二五年二月二十一日

截至本公告日期，董事會包括執行董事盧松青先生、盧伯卿先生及 PIPKIN Chester John 先生；非執行董事張傳旺先生及黃碧君女士；以及獨立非執行董事 CURWEN Peter D 先生、鄧貴彰先生及陳永源先生。

* 於開曼群島以鴻騰精密科技股份有限公司的名稱註冊成立的有限公司，並以鴻騰六零八八精密科技股份有限公司於香港經營業務